

ATM-8200A

全自動ウェーハマウンター

Full-Automatic Wafer Mounter

【概要 - Outline - 】

◆ダイシング前工程として、専用フレームへのウェーハマウントを全自動で行う装置です。

The machine automatically mounts a wafer on a film frame as preliminary process for dicing.

装置サイズは世界最小で真空チャンバーの採用により、極薄ウェーハ(厚み:175μm / Ф8 インチ)にも対応できます。

【特長 - Features - 】

- ◆世界最小サイズのΦ4・5・6・8 インチ対応の全自動ウェーハマウンターです。
- ◆テープにウェーハを真空中で貼付けますので、気泡の発生が無く、貼付けローラーの荷重も少なくてすみ、Mount the wafer onto the tape in vacuum chamber will prevent from air bubbles, minimize the load of the pressing roller,

ウェーハダメージを与えません。 and provide no damage to the wafer.

- ◆特殊テーブルの使用により、外周 3mm を除くウェーハ表面は完全にノーコンタクトで、且つ、吸着による The mounting table is non contact with wafer surface at all except around 3mm in its circumference,
 - ウェー八固定を行いませんので、ウェーハへダメージを与えません。 and wafer position fixing with no vacuum hole will provide no damege to the wafer.
- ◆専用フレームにテープを貼付けるステージとテープにウェーハを貼付けるステージを別に設けていますので、
 Tape lamination stage and wafer mounting stage is separated.

テープの使用量が低減され、且つ、どの様なテープにも対応が出来ます。 It saves tape consumption and it's applecable to any dicing tape.

- ◆操作は見やすいタッチパネル式で、トラブル時の状況も表示します。
 Touch pane (I flat operation panel) is easy to operated, and and able to indicate troubled point.
- ◆非接触オリフラ合わせを標準装備しています。 Non contact flat alignment (standard spec)

仕 様 Specification		ATM-8200A
スループット Throughput		95 枚 /h(ご使用条件により異なります Depend on data setting)
対応ウェーハサイ	ズ Wafer Size	4 · 5 · 6 · 8 inch
フレームサイズ Frame Size		2-6-1 / 2-8-1
使用テープ幅 Tape Width		6 inch: W 230 mm / 8 inch: W 300 mm
ユーティリティ	電源 Power	AC100V 単相 Single phase 50/60Hz 2.0KVA
Utilities	空気源 air	压力 Pressure 0.5Mpa 300NI/min
装置寸法 Demension		W 1,326 × D 1,150 × H 1,800 mm
重量 Weight		700 kg

※ 外観・仕様は改良の為、予告なく変更する場合があります。

System appearance and specifications are subject to change without prior notice from the supplier.



本 社/〒634-8580 奈良県橿原市新堂町 313-1
TEL.0744-24-6608 FAX.0744-24-8352
URL http://www.takatori-g.co.jp E-mail info@takatori-g.co.jp